FOR IMMEDIATE RELEASE

# シリコントポロジー、TSMCデザインセンターアライアンス（DCA）に加盟

**台湾新竹、2022年6月23日 -** 台湾を拠点とするASIC/SoC物理レイアウト設計サービスの有力企業シリコントポロジーは本日、TSMC Open Innovation Platform®（OIP）のデザインセンターアライアンス（DCA）に加盟したことを発表した。シリコントポロジーはアナログ・ミックスドシグナル・メモリ・RF回路のレイアウトサービスを専門とし、7nm・5nm・4nm・3nmといったTSMCが業界をリードする先端プロセステクノロジー及びスペシャルティテクノロジーに精通している。

シリコントポロジーは、25年以上に渡りASIC物理レイアウトサービスに注力し、高速インターフェースIP（SerDes、DDR PHY等）・RF Tx/Rx・高精度ADC・低電力オシレーター・電源管理IC・ドライバーIC及び各種メモリ設計アプリケーションと様々な領域のサービス経験を積んできた。台湾・シリコンバレー・東京・南京にあるグローバルサポートサービスセンターには200人以上のレイアウト専門家がおり、世界各国のお客様により効率的な現地サービスを提供可能。

TSMCのデザインインフラストラクチャー・マネジメント部門のバイスプレジデントSuk Leeは「シリコントポロジーがTSMC OIPのデザインセンターアライアンス（DCA）に加盟して頂くことで、TSMCの先端テクノロジーを使用した高品質のチップ設計に対する業界の高まる需要に応えることが可能になる」と述べ、「シリコントポロジーは、貴重なエコシステムパートナーとして、多岐にわたるICレイアウトサービスのご経験とノウハウにより共通の顧客を支援し、差別化された製品を迅速に市場に投入することを可能にする」と評価した。

シリコントポロジー社長Sean Linは「長期的にTSMCと協業させて頂いたお蔭で、弊社は常にTSMCの先端プロセステクノロジーに対応できるレイアウトスキルと人材を培って参りました。我々はTSMCのデザインセンターアライアンスに加盟し、共通の顧客に対して専門的且つ付加価値のあるレイアウトサービスを提供し、市場投入までの時間を短縮するお手伝いが出来ることを誇りに思います。」

### シリコントポロジーについて

1995年に設立されたシリコントポロジーは、アナログ回路レイアウト設計を中心としたICレイアウトサービスを提供している。高度な訓練を受けた経験豊富なレイアウトエンジニアを200人以上抱えており、チームワークを通じて、最も専門的な業界経験、スキル及びカスタマイズサービスを提供し、顧客の製品設計を成功に導くよう支援します。詳しくはシリコントポロジー社のウェブサイトをご覧ください： <https://stlayout.com>